

NUMBER 316131

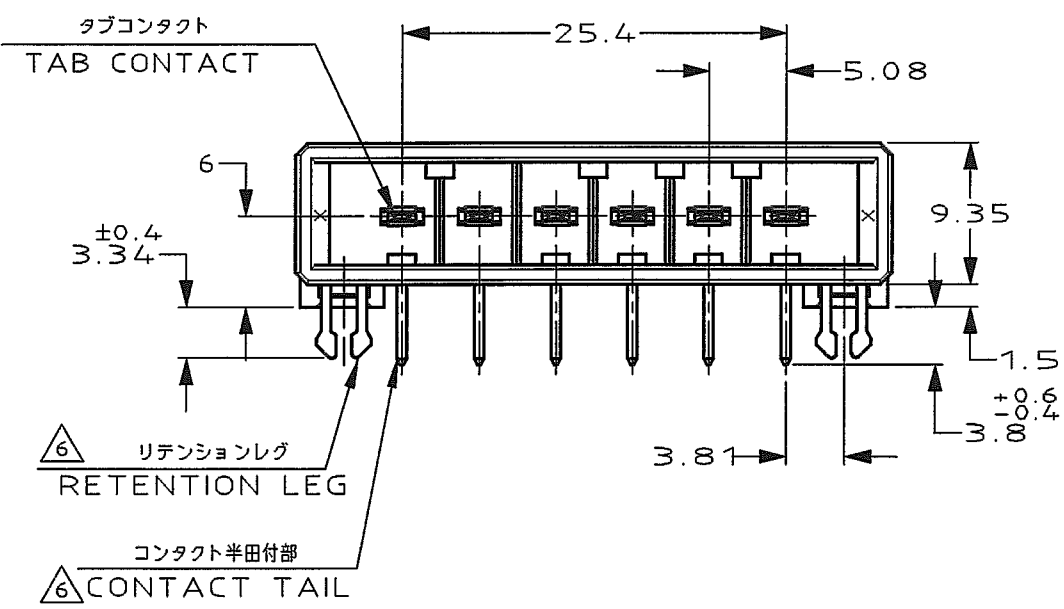
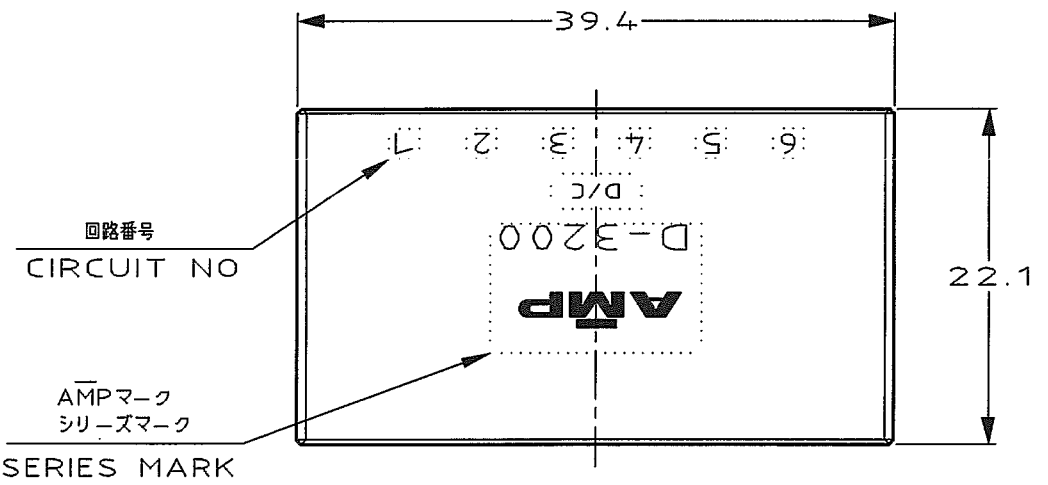
3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

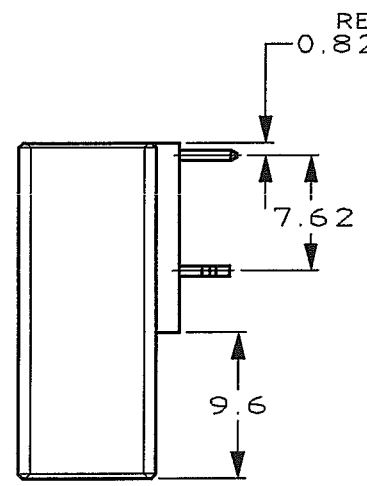
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

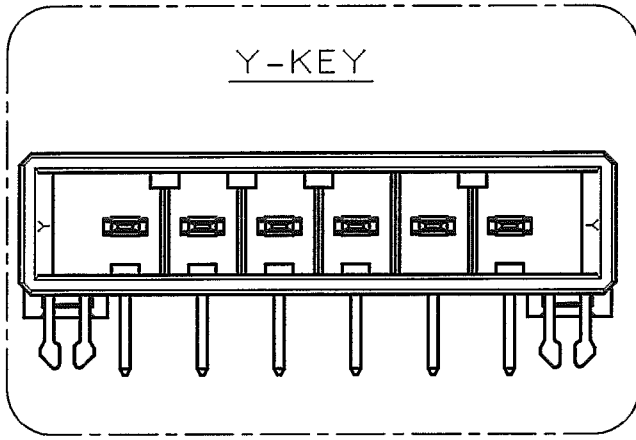
AMP-J
REV.10/83



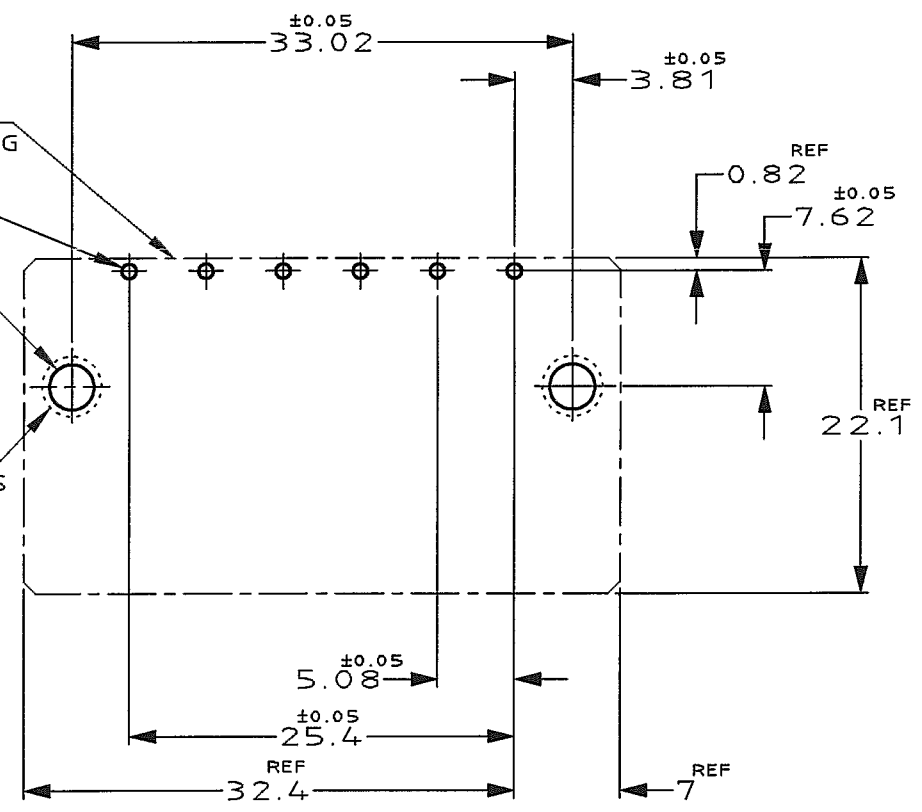
6	4	2-316131-5	Y
6	3	2-316131-3	Y
6	2	2-316131-2	Y
6	4	1-316131-5	X
6	3	1-316131-3	X
6	2	1-316131-2	X
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	KEY	



コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING
6-φ1.1
DIA1.1±0.1 6PLACES
スルーホール 2-φ3
DIA3±0.1 2PLACES
ラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA4MIN 2PLACES



- NOTES
- MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
 - FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- 注記
- 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.76μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

B	REVISED(FJDO-0039-03)	TS	5.1	1/3
A	REVISED(FJDO-0114-03)	TS	SM	25.APR/03
0	RELEASED (FJ00-2557-95)	KI	YI	31/JUL/95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1995
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco
Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
mm ² (AWG -)	mm ²	5 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
DR. 26/JUL/95 K.IKEDA	DE. 26/JUL/95 K.IKEDA	10mm 3mm下 : ±0.2 10mm 3mm下 : ±0.3 30mm 100mm下 : ±0.4 角 度 : ±3°
CHK. 31/JUL/95 Y.ISHIKAWA	APP. 31/JUL/95 S.MANABE	SIZE LOC NUMBER A3 J C-316131
		SCALE REV. SHEET 2-1 B 1 of 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面